

2024年職涯發展季：校園徵才簡表

**日期：113年3月27日(星期三)**

**地點：本校學生活動中心**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 | 虹冠電子工業股份有限公司 | 屬性 | □資訊通訊 □生產製造□貿易業務 □補教文化□餐飲服務 □物流倉儲 ■其他 半導體製造業  |
| 營利事業統一編號 | 16130417 |
| 公司地址 | 新竹市新竹科學園區園區二路11號5樓新北市汐止區新台五路一段96號21樓 | 電話/傳真 | 02-26963558/26963559 |
| 聯絡人/職稱 | 陳昀渝/行政資訊部專員 | E-mail | angela\_chen@championmicro.com.tw |
| 公司簡介 | 本公司成立於 87 年 12 月30 日，資本額 6 億 ，100 年 3 月 21 日 已以科技事業正式上市，為專業高功率IC之研發、製造及銷售，致力於高功率AC-DC（交流轉直流）整合型電源管理IC，並推出具節省電力及高效能功率IC，其產品主要應用在桌上型電腦、雲端伺服器及LED顯示器等產品。 |
| 福利制度 | 1) 員工分紅入股制度2) 婚、喪、住院補助3) 年節、慶生禮券4) 年度國內外旅遊5) 彈性上下班時間6) 週休二日 | 7) 享團保8) 退休金提撥9) 每年免費健康檢查10) 教育訓練11) 不定期免費供應下午茶、點心12) 優於勞基法，提供7天彈性休假 |
| 徵才職稱及條件 | 職缺名稱 | 名額 | 科系 | 工作內容 | 薪資待遇 |
| FAE工程師(電源IC應用工程師) | 3-5 | 電機電子工程相關 | 1.驗證IC Function2.協助客戶解決IC應用上之問題 | 待遇面議（經常性薪資達 4 萬元或以上） |
| 產品封裝工程師 | 1 | 工業工程、電機電子工程、光電工程相關 | 1.評估暨研發新產品封裝型式。2.專案跟催並整合資源以導入產品封裝量產作業。3.定期報告專案進展。4.撰寫專案相關文件。 | 待遇面議（經常性薪資達 4 萬元或以上） |
| 製造整合系統工程師(MES) | 1 | 工業工程、資訊工程相關 | 1.ERP作業流程系統改善2.製令、工單及生產報表自動化3.加工費統計及請款自動化 | 月薪40,000元以上 （固定或變動薪資因個人資歷或績效而異） |
| 學生需準備履歷 | 🗹是 □ 否 | 進行現場面試/徵才 | 🗹是 □ 否 | 需求類型 | 🗹全職 □工讀 |